

PE 10/191  
Santiago, 28 de octubre de 2010.

Señor  
Fernando Coloma Correa.  
Superintendente de Valores y Seguros.  
Presente

**Ref.: HECHO ESENCIAL. Codelco Chile,  
Inscripción Registro de Valores N° 785.**

De nuestra consideración:

De conformidad a lo establecido en la Ley N°18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, informo a usted que el día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US\$1.000 millones a 10 años plazo, con un cupón de 3.75% anual y un rendimiento de 3.96% anual.

Estas condiciones representan la tasa de interés más baja obtenida por algún emisor corporativo latinoamericano en los mercados financieros internacionales.

La emisión registró una sobresuscripción de 3.5 veces y atrajo órdenes de más de 200 inversionistas del mercado de High Grade.

Esta es la octava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos Deutsche Bank y HSBC. Las condiciones finales se lograron después de un exitoso proceso de roadshow que comprendió más de 45 inversionistas e incluyó a Europa y Estados Unidos.

Estos recursos permitirán refinanciar pasivos y financiar el desafiante plan de inversiones mineras de la Corporación.

Esta histórica transacción evidencia el reconocimiento que el mercado financiero otorga nuevamente a Codelco.

Saluda atentamente a Ud.,



Diego Hernández Cabrera  
Presidente Ejecutivo